

Title (en)

Process for placing a vegetation-supporting layer on a slope or a wall.

Title (de)

Verfahren zum Anbringen eines der Begrünung dienenden Vegetationsunterbodens an einer Böschung und/oder an einer Wand.

Title (fr)

Procédé pour apporter une couche de support de végétation sur un talus ou un mur.

Publication

EP 0391857 A1 19901010 (DE)

Application

EP 90810273 A 19900405

Priority

CH 130789 A 19890407

Abstract (en)

A vegetation-supporting layer (5), as a mixture consisting of a substrate, a soil stabiliser and water, is applied, preferably with a spray device, to a slope or a wall (1). The thickness of the vegetation-supporting layer is at most 25 cm. Through the action of the soil stabiliser, the substrate adheres in itself and to three-dimensional grids (3) attached beforehand. Erosion or slippage in the face of nasty weather conditions is prevented. The process permits, for example, cost-effective, subsequent grassing of steep revetments or walls. <IMAGE>

Abstract (de)

An einer Böschung und/oder an einer Wand (1) wird ein der Begrünung dienender Vegetationsunterboden (5) als Gemisch aus einem Substrat, einem Bodenfestiger und Wasser vorzugsweise mit einer Spritzvorrichtung aufgetragen. Die Schichtdicke des Vegetationsunterbodens beträgt höchstens 25 cm. Das Substrat haftet durch die Wirkung des Bodenfestigers in sich und an vorgängig angebrachten dreidimensionalen Gittern (3). Ein Auswaschen oder Abrutschen bei widerlichen Witterungsverhältnissen wird verhindert. Das Verfahren gestattet beispielsweise ein kostengünstiges nachträgliches Begrünen von steilen Stützwänden oder Mauern.

IPC 1-7

E02D 17/20; **E02D 29/02**

IPC 8 full level

E02D 17/20 (2006.01); **E02D 29/02** (2006.01)

CPC (source: EP)

E02D 17/20 (2013.01); **E02D 29/0266** (2013.01)

Citation (search report)

- [X] AT 320529 B 19750210 - HUGO MEINHARD SCHIECHTL ING DR, et al
- [A] DE 3139432 A1 19830421 - BIRKENMEIER BAUSTOFF [DE]
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 13, no. 77 (M-801)(3425) 22 Februar 89, & JP-A-63 277321 (RAITO KOGOIO KK) 15 November 88,
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 4, no. 150 (M-37)(632) 22 Oktober 80, & JP-A-55 101621 (TETSUROU YUJI) 02 August 80,

Cited by

CN114457841A; WO9617134A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE FR LI LU

DOCDB simple family (publication)

EP 0391857 A1 19901010; CH 681376 A5 19930315

DOCDB simple family (application)

EP 90810273 A 19900405; CH 130789 A 19890407